

東京応化工業株式会社 決算補足説明資料

-2024年12月期 第1四半期決算-

2024年5月13日
東京応化工業株式会社

tok

© 2024 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

2024年12月期 第1四半期 サマリー

01

2024年12月期 第1四半期実績

- 売上高は、前年比65億円 (+17.0%) 増収の450億円。
エレクトロニクス機能材料、高純度化学薬品ともに
半導体市況のゆるやかな回復および為替の効果により増収。
- 営業利益は、前年比4億円 (+7.4%) 増益の57億円。
売上高の増加に加え、為替の効果も重なった。

2024年12月期 業績予想

※2024年 2月13日 発表済み

- 前提条件：
生成AIの本格的な普及等による各種最終製品の需要増加や、
顧客製品在庫水準の低下に伴う半導体市場の回復を見込む。
- 足元の市況や当社製品の採用状況、顧客新規工場の稼働開始等を
鑑み、前年度より大幅な増収増益を予想。
売上高1,792億円 (+10.4%)、営業利益268億円 (+18.0%)。

tok

© 2024 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

(百万円、%)

	2023/12 1Q	2024/12 1Q		
			増減	増減率
売上高	38,463	45,017	+6,554	+17.0%
営業利益	5,392	5,793	+401	+7.4%
経常利益	5,762	6,039	+276	+4.8%
親会社株主に 帰属する四半期純利益	2,157	3,599	+1,442	+66.9%
EBITDA	7,286	7,839	+552	+7.6%

期中平均為替 (USドル) : 131.5円/ドル (2023/12 1Q) ⇒ 147.8円/ドル (2024/12 1Q)

- 売上高 : 半導体市況のゆるやかな回復に伴いエレクトロニクス機能材料、高純度化学薬品の売上増加が見られたほか、為替の効果により前年比+17.0%増収。
- 営業利益・経常利益 : 一部固定費の増加が見られたものの、売上の増加に加え、為替の効果も重なり、営業利益は前年比+7.4%増益。経常利益は前年比+4.8%増益。
- 親会社株主に帰属する四半期純利益 : 営業利益の増加や昨年計上した事業再編費用がなくなったため、前年比+66.9%増益。



© 2024 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

(百万円、%)

	2023/12 1Q	2024/12 1Q		2024/12 上期計画		
			増減	増減率	計画値	進捗率
売上高	38,463	45,017	+6,554	+17.0%	83,100	54.2%
エレクトロニクス機能材料	20,437	24,460	+4,023	+19.7%	45,600	53.6%
高純度化学薬品	17,454	20,065	+2,611	+15.0%	36,500	55.0%
その他	570	490	△79	△14.0%	1,000	49.1%
営業利益	5,392	5,793	+401	+7.4%	11,100	52.2%

期中平均為替 (USドル) : 131.5円/ドル (2023/12 1Q) ⇒ 147.8円/ドル (2024/12 1Q)

- 売上高 : 半導体需要のゆるやかな回復に加えて為替の効果もあり、上期計画進捗率54.2%。
- エレクトロニクス機能材料 (売上高) : 半導体前工程用フォトリソの先端材料やKrFレジストの売上が増加したほか、パッケージ材料、WHS関連材料も堅調に推移し、上期計画進捗率53.6%。
- 高純度化学薬品 (売上高) : 新興市場、アジア各地域での旺盛な需要を受け、上期計画進捗率55.0%。
- 営業利益 : 売上の増加に加えて為替の効果も重なり、上期計画進捗率52.2%。



© 2024 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

	2023/12 1Q	2024/12 1Q		2024/12 年間計画		
		増減	増減率	計画値	進捗率	
設備投資費	1,129	2,820	1,691	+149.7%	27,300	10.3%
減価償却費	1,893	2,045	151	+8.0%	8,300	24.6%
研究開発費	2,909	4,051	1,141	+39.2%	14,500	27.9%

- 設備投資等： 上期計画はおおむね計画通りに進捗。
- 減価償却費： 計画通りに進捗。
- 研究開発費： 一部費用の前倒し計上が見られたものの、計画通りに進捗。



© 2024 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

www.tok.co.jp

<ご注意>

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。

したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。



© 2024 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

Appendix



装置事業譲渡に伴うセグメント開示の変更について

07

		22年度までのセグメント	23年度以降のセグメント
材料事業	エレクトロニクス 機能材料	<ul style="list-style-type: none"> ● 半導体用フォトレジスト (g/i線・KrF・ArF) ● 高密度実装材料 (パッケージ材料・MEMS材料) ● LCD材料 (TFT材料・CF材料) ● その他 (EUV・その他) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 半導体前工程用フォトレジスト (レガシー材料・KrF・先端材料) ● 半導体後工程関連材料 (パッケージ材料・MEMS材料・WHS*関連材料) ● ディ스플레이材料・その他 (TFT材料・CF材料・その他)
	高純度化学薬品	● シンナー・現像液・洗浄液	● シンナー・現像液・洗浄液
	その他		<ul style="list-style-type: none"> ● その他装置 ● WHS*関連装置 (2023年2月28日まで) ● プラズマアッシング装置 (2023年2月28日まで)
装置事業	<ul style="list-style-type: none"> ● WHS*関連装置 ● プラズマアッシング装置 ● その他装置 ● WHS*関連材料 <p>*WHS：ウエハハンドリングシステムの略</p>	<p>2023年3月1日より AIメカテック社へ事業譲渡</p>	<p>(注1) レガシー材料：g、i線レジスト等 (注2) 先端材料：ArF・EUVレジスト等</p>

